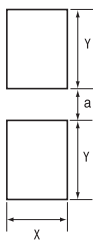


表面安装品

■推荐焊盘尺寸

(单位: mm)

● 芯片型铝电解电容器普通结构品



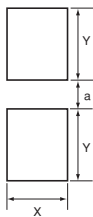
| 尺寸 | X | Y | a |
|-----------------|-----|-----|-----|
| φ4 | 1.6 | 2.6 | 1.0 |
| φ5 | 1.6 | 3.0 | 1.4 |
| φ6.3 | 1.6 | 3.5 | 1.9 |
| φ8×5.4L、φ8×6.2L | 2.5 | 4.0 | 2.1 |
| φ8×10L | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
| φ10 | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
| φ12.5 | 2.0 | 7.3 | 3.0 |
| φ16 | 2.0 | 7.9 | 5.3 |
| φ18 | 2.0 | 8.9 | 5.3 |

● 导电性高分子铝固体电解电容器

| 尺寸 | X | Y | a |
|------|-----|-----|-----|
| φ5 | 1.6 | 3.0 | 1.4 |
| φ6.3 | 1.6 | 3.5 | 2.1 |
| φ8 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
| φ10 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |

● 导电性高分子品 (FPCAP)

(RPS, RPA, RHS, RHA, RSS, RSA, RSB, RFS, RFA, RSL, RDS, RKS)



| 尺寸 | X | Y | a | |
|-------|------|-----|-----|-----|
| FPCAP | φ4 | 1.6 | 2.6 | 1.0 |
| | φ5 | 1.6 | 3.0 | 1.4 |
| | φ6.3 | 1.6 | 3.5 | 2.1 |
| | φ8 | 1.9 | 4.2 | 2.8 |
| | φ10 | 1.9 | 4.4 | 4.3 |

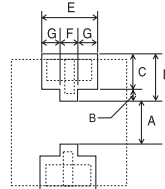
● 芯片型铝电解电容器抗振结构产品

(UCD、UCM、UCZ、UCH、UCX、UUE、UBC、UBH)

① φ6.3~10

| 尺寸 | X | Y | a |
|-----------|-----|-----|-----|
| φ6.3×7.7L | 3.0 | 4.0 | 1.6 |
| φ6.3×10 L | 3.0 | 4.0 | 1.6 |
| φ8×10 L | 4.3 | 5.3 | 2.0 |
| φ10×10 L | 4.3 | 5.6 | 3.3 |

② φ12.5~18



| 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| φ12.5 | 3.0 | 2.3 | 5.0 | 7.3 | 7.0 | 2.0 | 2.5 |
| φ16 | 5.3 | 2.9 | 5.0 | 7.9 | 7.0 | 2.0 | 2.5 |
| φ18 | 5.3 | 3.1 | 5.8 | 8.9 | 11.0 | 2.0 | 4.5 |

● 导电性高分子铝固体电解电容器抗振结构品 (PCX, PCR, PCM, PCH, PCZ)

| 尺寸 | X | Y | a |
|-----------|-----|-----|-----|
| φ6.3×8L | 3.0 | 4.0 | 1.6 |
| φ8×10.5L | 4.3 | 5.3 | 2.0 |
| φ10×10.5L | 4.3 | 5.6 | 3.3 |
| φ10×13.2L | 4.3 | 5.6 | 3.3 |

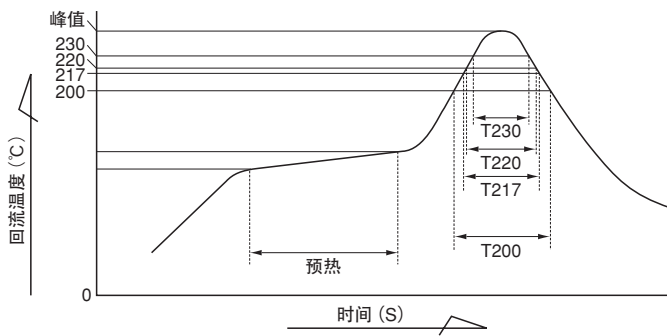
● 导电性高分子混合铝电解电容器 (GYA, GYB, GYC, GYD, GYE, GYF, GXC)

| 尺寸 | X | Y | a |
|-------------------|-----|-----|-----|
| φ6.3 | 1.6 | 3.5 | 1.9 |
| φ8 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
| φ10×10L、φ10×12.5L | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
| φ10×16.5L | 2.8 | 4.3 | 3.5 |

● 导电性高分子混合铝电解电容器抗振结构品

| 尺寸 | X | Y | a |
|-----------|-----|-----|-----|
| φ6.3×7.7L | 3.0 | 4.0 | 1.6 |
| φ8×10 L | 4.3 | 5.3 | 2.0 |
| φ10 | 4.3 | 5.6 | 3.3 |

芯片型回流焊接的推荐条件



T200 : 电容器表面超过+200℃的时间
 T217 : 电容器表面超过+217℃的时间
 T220 : 电容器表面超过+220℃的时间
 T230 : 电容器表面超过+230℃的时间
 温度测量点: 铝壳头部
 超出容许范围使用时请咨询我们。

| No. | 品种·系列名称 | 尺寸 | 预热 | 峰值温度 | 超过230℃的时间 | 超过220℃的时间 | 超过217℃的时间 | 超过200℃的时间 | 回流次数 |
|-----|---|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 1 | 芯片型导电性高分子铝固体电解电容器 (PCF, PCJ, PCK, PCG, PCS, PCL, PCW, PCV, PCX, PCR, PCA, PCM, PCH, PCZ) | - | 150~200℃, 60~180秒以内 | 260℃ Max. | 60s以内 | - | 70s以内 | - | 仅限1次 (部分系列※4) 2次以内※5 |
| | | - | | 250℃ Max. | 60s以内 | - | 70s以内 | - | 2次以内※5 |
| 2 | 导电性高分子混合铝电解电容器 (GYA, GYB, GYC, GYD, GYE, GYF, GXC) | - | | 260℃ Max. | 40s以内 | - | 50s以内 | - | 仅限1次 |
| | | - | | 250℃ Max. | 30s以内 | - | 40s以内 | - | 2次以内※5 |
| 3 | 芯片型铝电解电容器 (UZT, UWP※1, UWT※1, UWG, UUP, UUA, UUL, UCW, UCD※2, UCL, UCM※2, UCV, UUD, UUB※3, UCJ, UCZ※2, UCH, UCX※2, UUX※3, UUQ, UCQ, UUE※2, UBC※2, UBH) | ~φ10 | | 250℃ Max. | 30s以内 | - | 40s以内 | - | 2次以内※5 |
| 4 | 芯片型铝电解电容器 (UWP, UWT) | φ8×5.4L | 150~180℃, 120秒以内 | 245℃ Max. | - | 30s以内 | 30s以内 | - | 2次以内※5 |
| 5 | 芯片型铝电解电容器 (UZG) | 3.9L | | 240℃ Max. | - | 30s以内 | 30s以内 | - | 2次以内※5 (φ6.3:仅限1次) |
| 6 | 芯片型铝电解电容器 (UUX (160-400V), UUB (160-400V), ULT, ULH, ULR, ULV) | ~φ10 | | 240℃ Max. | - | 30s以内 | 30s以内 | - | 2次以内※5 |
| 7 | 芯片型铝电解电容器 (UCD, UCM, UCK, UCZ, UYA, UCX, UUG, UUJ, UUN, UUE, UBC) | φ12.5~ | | 240℃ Max. | - | - | 30s以内 | 60s以内 | 2次以内※5 |
| 8 | 芯片型铝电解电容器※6 (UWZ, UWD, UWH) | - | | 260℃ Max. | 60s以内 | - | 70s以内 | - | 2次以内※5 (φ8×6.2L和φ10×10L: 仅限1次) |

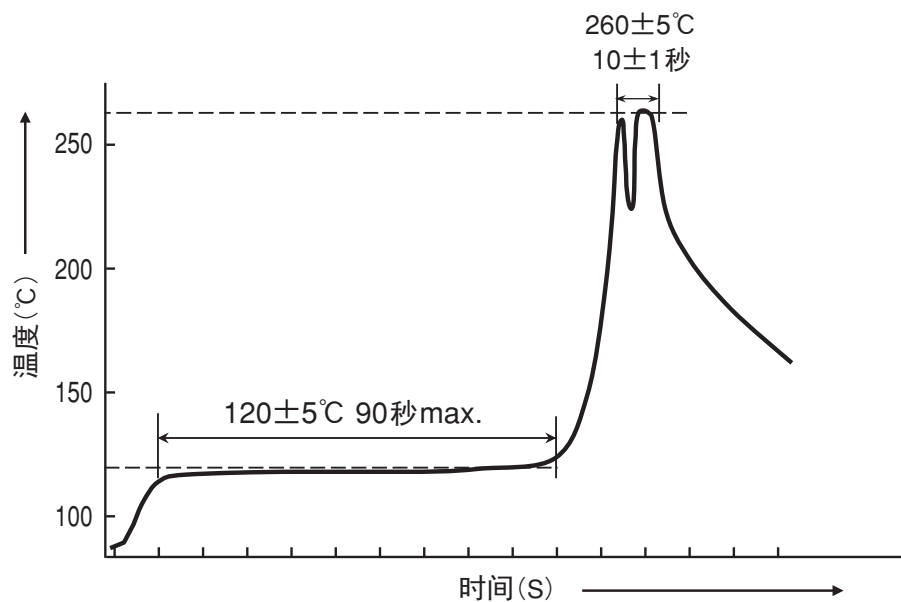
s=秒

- ※1 : φ8×5.4L请参照No.4.
- ※2 : φ12.5~请参照No.7.
- ※3 : 160~400V请参照No.6.
- ※4 : 包括PCR, PCA, PCM, PCH 和 PCZ系列.
- ※5 : 请在第1次和第2次回流之间留出充分的产品冷却时间.
- ※6 : 高温回流对应品.

关于商品目录中记载的ESR阻抗值

引线型: 测定位置为引线端子底部。
 芯片型: 测定位置为距离树脂板的孔口最近的电极部。
 除非另有记载说明, 否则均为初始值。

引线型铝电解电容器 流焊焊接的建议条件



流焊焊接的建议条件

预热： $120 \pm 5^\circ\text{C}$ 90秒 max.

流动： $260 \pm 5^\circ\text{C}$ 10 ± 1 秒

测温位置

基板背面端子部位（见图 - 温度测量位置）

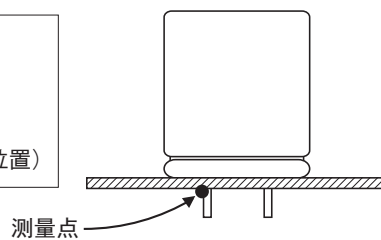


图 - 温度测量位置

烙铁焊接的建议条件

烙铁头温度： $350 \pm 10^\circ\text{C}$ $3 + 1 / - 0$ 秒

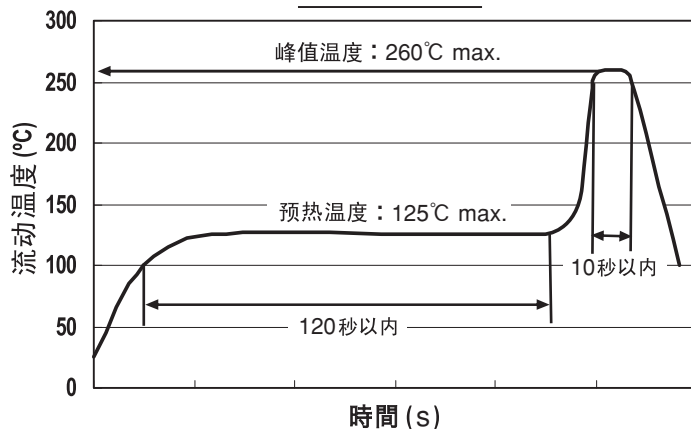
※导电性高分子铝固体电解电容器不包括在内，请另外单独联系我们。

FPCAP 无铅及RoHS指令适合焊接条件

流动焊 (引线型)

RNS、RR7、RR5、RL8、RE5、RS8、RF8、RNU、RNE、RNL、RS6、RHT

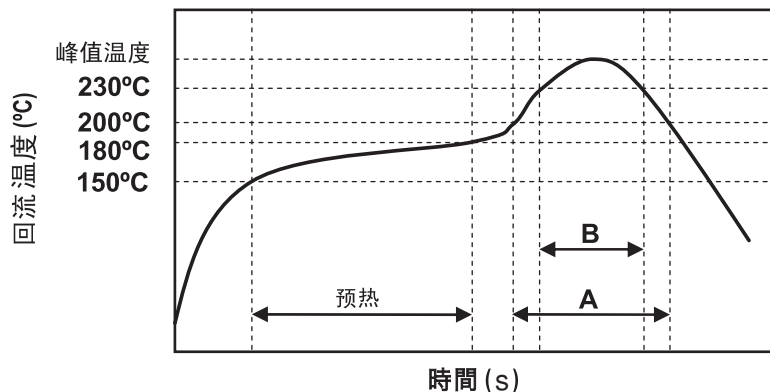
推荐流动条件



回流焊 (芯片型)

RPS、RPA、RHS、RHA、RSS、RSA、RSB、RFS、RFA、RSL、RDS、RKS

推荐回流焊条件



| 項目 | 推荐条件 1 | 推荐条件 2 | 推荐条件 3 |
|------|---|--------------------|--------------------|
| 系列名称 | RPS、RPA、RHS、RHA、RSS、RSA、RSB、RFS、RFA、RSL | | RDS、RKS |
| 峰值温度 | 260°C max. | 250°C max. | 260°C max. |
| 预热 | 150~180°C 90秒以内 | 150~180°C 90秒以内 | 150~180°C 90秒以内 |
| A | 200°C 以上 60秒以内 | 200°C 以上 60秒以内 | 200°C 以上 60秒以内 |
| B | 230°C 以上 40秒以内 | 230°C 以上 40秒以内 | 230°C 以上 40秒以内 |
| 回流次数 | 1次 | 2次以下 | 2次以下 |